

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 3 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 25 年 4 月 18 日 (2013.4.18)

【公表番号】特表 2012-519137 (P2012-519137A)  
 【公表日】平成 24 年 8 月 23 日 (2012.8.23)  
 【年通号数】公開・登録公報 2012-033  
 【出願番号】特願 2011-552168 (P2011-552168)  
 【国際特許分類】

C 0 4 B 38/00 (2006.01)

C 0 4 B 35/64 (2006.01)

【F I】

C 0 4 B 38/00 3 0 4 Z

C 0 4 B 35/64 C

【手続補正書】  
 【提出日】平成 25 年 2 月 26 日 (2013.2.26)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

粘土材料と有機材料とを含む原料を未焼成構造体の形態に形成する工程と、  
 前記未焼成構造体を焼成環境中で焼成する工程であって、前記焼成は、  
前記未焼成構造体のコアのごく近傍で前記粘土材料の脱水が開始される前に前記実質的に有機材料の焼き払いを完了させるのに十分な第 1 の時間にわたり、焼成環境を第 1 の閾値温度を含む温度まで加熱すること、および

粘土脱水が起こる第 2 の時間にわたり、前記第 1 の閾値温度から前記第 1 の閾値温度より高い第 2 の閾値温度まで前記焼成環境を加熱すること、  
を含むものである、焼成する工程と、  
 を含み、

前記第 1 の閾値温度から前記第 2 の閾値温度までの平均ランプ速度が、約 1 1 / 時 ~ 約 7 5 / 時の範囲内である、  
 方法により製造されることを特徴とする、多孔性セラミック構造体。

【請求項 2】

前記第 1 の閾値温度が約 4 2 5 であることを特徴とする、請求項 1 に記載のセラミック構造体。

【請求項 3】

前記第 1 の時間にわたり前記焼成環境を前記第 1 の閾値温度を含む温度まで加熱することが、約 1 2 / 時以下の平均ランプ速度で前記焼成環境を加熱することを含むことを特徴とする、請求項 2 に記載のセラミック構造体。

【請求項 4】

前記第 2 の閾値温度が約 7 5 0 であることを特徴とする、請求項 1 に記載のセラミック構造体。

【請求項 5】

前記第 1 の時間にわたり前記焼成環境を前記第 1 の閾値温度を含む温度まで加熱することが、少なくとも所定の最小時間にわたり前記焼成環境を前記第 1 の閾値温度を含む温度まで加熱することを含むことを特徴とする、請求項 1 に記載のセラミック構造体。

**【請求項 6】**

前記第 1 の閾値温度が約 4 0 0 ～約 4 2 5 の範囲内にあり、かつ前記所定の最小時間が約 2 4 時間～約 4 6 時間の範囲内にあることを特徴とする、請求項 5 に記載のセラミック構造体。